可研磨54um的極薄基板

新型極薄基板用研磨機 —ETII-700—

NEW

專利申請中

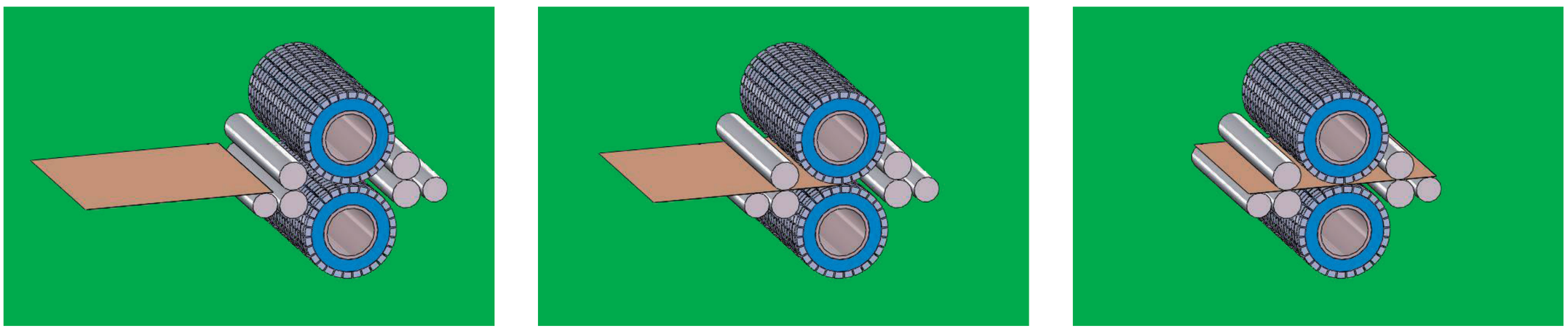
特 點

對既有的ET型機加以改進，不僅薄板的研磨變為可能，也可對應普通基板。
可上下兩面同時研磨並採用水平方式，提高了生產效率。
此研磨系統中，基板兩面承受的研磨壓始終保持一定，減少了薄板研磨後的彎曲問題。薄板研磨問題中常見的基板折角·壓痕等現象也能最大限度的消除。
這是石井表記所研發的業界獨一不二的最高端研磨機，可在今後的PCB製作中發揮重要作用。

規　格

基板尺寸	W260 × L260 ～ W700 × L700mm
板　厚	0.054 ～ 2.0mm
有效幅寬	700mm　工作高：900+/-15mm
線　速	常用2.5m/min
機械總重量	約2300kg

傳送・研磨 同時進行方式



ISHII HYOKI
株式会社 石井表記